

Grinding Technology Japan と SiC,GaN 加工技術展で

深掘りした4つのトピックス

2025年3月に幕張メッセで「Grinding Technology Japan 2025」および「SiC,GaN 加工技術展 2025」が開催されました。展示会では限られた時間内で多くのブースを回る必要があるため個人の興味や既知の分野に偏って視察することが多いと思います。そこで本講演では企画委員が専門知識に基づき今後の可能性をみた、深掘りしたい技術を抽出しました。業界での技術やニーズが、思わぬ形で自分の仕事に応用できることもあります。本講演を通じて、加工現場や製品開発における応用のヒントとなる情報を提供します。

共 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

公益社団法人精密工学会 『超砥粒ホイールの研削性能に関する研究専門委員会』

日 時：2025年8月29日（金）13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と **ZOOMのハイブリッド形式**



会 場：明治大学駿河台キャンパスリバティタワー9階 1096 教室

※ オンラインによる参加をご希望の方には、後日、詳細情報をお知らせいたします。

13:00～13:05	開会挨拶	次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会委員長 日本大学 山田高三 氏
13:05～13:55	講演1 「「溜めない・止めない」～加工現場を実現するクーラント管理と精密濾過の最前線～」	ユアサ商事株式会社 深井裕詞 氏
13:55～14:45	講演2 「 SiC ウエハ等の切断加工の最新動向 」	合同会社プリマテック 留井直子 氏
14:45～15:05	<休憩>	
15:05～15:55	講演3 「 両頭平面研削盤の最新動向とドレスシステムの開発 」	日清工業株式会社 滝内史貴 氏
15:55～16:45	講演4 「 シリコンウエハー,SiC,GaNなどの両面研磨加工の最新動向 」	浜井産業株式会社 中村祐太郎 氏
16:45～16:50	閉会挨拶・事務連絡	超砥粒ホイール専門委員会委員長 向井良平 氏
17:10～19:10	技術交流会 講演会場近郊	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400円（税抜額14,000円+消費税1,400円），非会員アカデミア：6,600円（税抜額6,000円+消費税600円），学生：無料

※会員は5名/社まで、非会員は2名/社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず2名/社まで参加できます。3人目からは4,950円/人（税抜額4,500円+消費税450円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

（注）価格は消費税10%を含みます。

申込締切日：2025年8月8日（金）

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：◆次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局 田附宙美 宛

FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>

◆超砥粒ホイール研究専門委員会⇒明治大学工学部 澤野宏 宛

TEL: 044 934 7364 E-mail：sawano@meiji.ac.jp